

通 知

有關「2023 台灣半導體產業協會 TSIA 獎」已開始申請。請貴院於 111 年 12 月 1 日

(四) 前，將便簽與推薦學生申請資料送本組彙辦（如無人申請亦請務必回覆信箱或電話告知），謝謝。

★注意：

- 1、如需電子檔，請直接洽該會：吳經理 (03) 5913-477
- 2、依該會獎學金來文及辦法，本年度推薦「博士研究生半導體獎」、「具博士學位之新進研究人員」2 項，如各院推薦人數在 1 名以上者，請務必於便簽或申請案上註明「排序」。
- 3、請推薦同學將辦法中「9-1~9-5 掃描單一 PDF 檔案」上傳該會網站。

此致

理學院

工學院

電資學院

11/23 胡亭峰 4 文件

擬：

- 一、本案擬依循往例辦理，全份文件影送各系所查照轉知所屬人員。
- 二、請有意申請之博士研究生及新進研究人員(含教師、研究人員、博士後)務於本年 12 月 1 日(四)下午 5 時前將申請相關資料逕送達學校學生事務處生活輔導組劉思妤小姐(分機 62050)辦理。考量後續作業，請恕逾期不候。
- 三、若對本案有任何疑問，請逕洽本校承辦人劉思妤小姐(分機 62050)。

工學院庶工理
行政組 10.1/11/20

工學院高 管 (10)
專門委員 高 管 (340)

工學院全英工 謝宗霖
學生事務處主任 謝宗霖
工學院 院 長 陳文章 (B)

學生事務處生活輔導組

敬啟

承辦人：劉思妤

電話：62048 至 53 轉 219

信箱 syliu829@ntu.edu.tw



檔案：
保存年限：

中華民國台灣半導體產業協會

017-81
函

機關地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 1246 室
承辦人及電話：吳素敏資深協理 03-5913477

受文者： 國立臺灣大學

速別：最速件

密等及解密條件：無

發文日期：中華民國一一一年十月十五日

發文字號：(一一一)導協字第 〇四八 號

附件：2023「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表



主旨：檢送本會 2023「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表等相關附件，請 惠予公布並推薦優秀博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。

說明：

- 一、本會為獎勵國內博士研究生及具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、發明或致力投入產業合作活動並有具體貢獻，特舉辦 2023「TSIA 半導體獎：博士研究生」與「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」選拔活動。
- 二、檢附相關申請辦法、申請表、推薦函等文件，惠請公布並推薦 貴校優秀之博士研究生與具博士學位之新進研究人員參選。
- 三、受理申請日期為 2022 年 10 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日止。請於上述截止日前，依申請辦法相關規定請連結網址 <https://forms.gle/arYxSzQ9H9L6esDX8>，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 推薦資料文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔，聯絡資訊請參見申請辦法第十三項規定。
- 四、得獎名單將於 2023 年 3 月公布於本會官網 www.tsia.org.tw 並通知 貴校。

正本：國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立中正大學、國立中興大學、國立中山大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學

理事長 劉德音